

### BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## PATENT- UND **MARKENAMT**

# Offenlegungsschrift

® DE 101 33 217 A 1

⑤ Int. Cl.<sup>7</sup>: H 05 K 3/34

② Aktenzeichen:

101 33 217.3

② Anmeldetag:

9. 7.2001

4 Offenlegungstag:

23. 1. 2003

(7) Anmelder:

SEHO Systemtechnik GmbH, 97892 Kreuzwertheim, DE

(74) Vertreter:

Patent- und Rechtsanwälte Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, 81679 München

(72) Erfinder:

US

Diehm, Rolf Ludwig, 97877 Wertheim, DE; Liedke, Volker, 76774 Leimersheim, DE

66 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

195 27 398 A1 DE 37 37 457 A1 US 61 45 734 A

60 05 224 A

JP 4-179294 A.,In: Patents Abstracts of Japan, E-1277,Oct. 9,1992,Vol.16,No.488;

## Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Werfahren und Vorrichtung zum Verlöten von elektrischen Bauteilen auf Kunststofffolie

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verlöten von elektrischen Bauteilen an mit Lötwerkstoff versehenen Lötstellen auf einer mit aufgebrachten Leiterbahnen versehenen Kunststofffolie. Die Kunststofffolie wird auf einer unterhalb ihrer Schädigungstemperatur von der den Bauteilen abgewandten Seite her aufgeheizt und die den Bauteilen zugewandte Seite mit einem Heizgasstrom beaufschlagt, der durch eine Fenster aufweisende Schablone auf die zu verlötenden Stellen konzentriert wird.

#### Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verlöten von elektrischen Bauteilen an mit Lötwerkstoff versehenen Lötstellen auf einer mit aufgebrachten Leiterbahnen versehenen Kunststofffolie.

[0002] Kunststofffolien mit aufgebrachten Leiterbahnen und damit verlötete elektrischen Bauteilen sind vorteilhaft dann anwendbar, wenn eine Verlegung von elektrischen Leitungen in einer Weise erfolgt, bei der der betreffende Träger 10

eine gewisse Flexibilität aufweisen muss.

[0003] Aus diesen Gründen hat man bereits Kunststofffolien als Träger für Leiterbahnen und elektrische Bauteile verwendet, die wegen der beim Verlöten der elektrischen Bauteilen erforderlichen Temperaturen, die etwa bei 210°C liegen, eine entsprechende Wärmebeständigkeit aufweisen müssen. Derartige Kunststoffe sind teuer. Bisher hat man in diesem Zusammenhang als zugrunde liegenden Kunststoff Polyamid (PI) verwendet. Wegen der mit diesem Kunststoff verbundenen Kosten kommt eine daraus gefertigte Kunst- 20 stofffolie als Träger für Leiterbahnen in vielen Techniken nicht in Frage. Dies gilt vor allem für den Automobilbau, in dem Leiterbündel innerhalb eines Kraftfahrzeuges an vielen Stellen zu verlegen sind, wobei die betreffenden Träger beim Einsetzen der Leiterbahnen in ein in Fertigung befind- 25 liches Kraftfahrzeug erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

[0004] Der Versuch, billigere Kunststoffe als Träger für Leiterbahnen zu verwenden, ist bisher daran gescheitert, dass technisch geeignete und ausreichend billige Kunst- 30 stoffe die beim Verlöten auftretenden Temperaturen nicht vertragen. Entweder liegt der Aufgabe zugrunde, das eingangs geschilderte Verfahren so zu gestalten, dass es für bekannte, relativ billige Kunststoffe geeignet ist, wie Polyester-Derivate (PEN, PEPT), ohne dass bei der Verwendung 35 dieser Kunststoffe diese beim Verlöten irgendwie beeinträchtigt werden.

[0005] Erfindungsgemäß geschieht dies dadurch, dass die Kunststofffolie auf einer Temperatur dicht unterhalb ihrer-Schädigungstemperatur von der den Bauteilen abgewandten 40 Seite her aufgeheizt wird und die den Bauteilen zugewandte Seite mit einem Heizgasstrom beaufschlagt wird, der durch eine Fenster aufweisende Schablone auf die zu verlötenden Stellen konzentriert wird.

[0006] Bei diesem Verfahren wird erreicht, dass die Wär- 45 mezufuhr zu der Kunststofffolie auf ein Minimum begrenzt wird und nur dort einen höheren das Aufschmelzen des Lots ermöglichenden Wert erreicht, wo bereits Lötwerkstoff vorgesehen ist. Dies geschieht dadurch, dass zunächst aufgrund der Aufheizung der Kunststofffolie auf den dicht unterhalb 50 ihrer Schädigungstemperatur liegenden Betrag die insgesamt der Kunststofffolie zuzuführende Energie stark begrenzt ist. Es wird auch durch die Aufheizung der Kunststofffolie von dieser wegen ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit verbleiben und bestimmt durch den Temperaturunter- 55 schied zwischen Kunststofffolie und Schmelztemperatur des Lots nur relativ wenig Wärme mit einer minimalen Energie auskommt. Die dann an den Lötstellen aufzubringende durch den Heizgasstrom erzeugte höhere Wärme, lässt sich durch die Fenster aufweisende Schablone so stark konzen- 60 trieren, dass nur die zu verlötenden Stellen einem erhöhten Wärmezustrom ausgesetzt sind, womit die umgebenen Bereiche der Kunststofffolie praktisch keiner zusätzlichen Erwärmung ausgesetzt werden und daher eine Schädigung der kann.

[0007] Es wird noch darauf hingewiesen, dass in der internationalen Patentanmeldung WO 94/21415 in Zusammen-

hang mit Reflow-Löten von Flachbaugruppen, bei dem das Aufheizen der Lötstellen durch Strahlung in einem Heizraum erfolgt. Um dabei in dem Heizraum ausgewählte Bereiche von der Strahlung auszunehmen, wird in der Druckschrift ein Maskenträger vorgeschlagen, der aus einer Position außerhalb des Heizraumes in den Heizraum hinein verlagerbar und auf der Flachbaugruppe (Platine) absenkbar ist, wodurch für eine vorgegebene Zeit der ausgewählte Bereich gegen die Strahlung abgeschattet ist. Diese Lötmethode kommt für Kunststofffolien wegen der dabei entstehenden hohen Wärmeeinbringung nicht in Frage, da die durch die Erfindung verwendbaren Polyester-Derivate in dem durch die Strahlung aufgeheizten Heizraum sofort zusammenschmelzen würden.

[0008] Um ein Absließen von Wärme von der aufgeheizten Kunststofffolie zu vermeiden, was einen zusätzlichen unerwünschten Wärmebedarf auf Seiten der Kunststofffolie zur Folge hätte, wird nach dem Aufheizen der Kunststofffolie deren den Bauteilen abgewandte Seite wärmeisoliert. Solange diese Wärmeisolation besteht, behält daher die Kunststofffolie ihre durch Aufheizen gegebene Temperatur bei. [0009] Um den Vorgang der Wärmezufuhr möglichst zu konzentrieren und damit so kurzzeitig wie möglich zu gestalten, gestaltet man das Aufheizen der Kunststofffolie und der Wärmebeaufschlagung der den Bauteilen zugewandten Seite der Kunststofffolie zweckmäßig so, dass dies im Wesentlichen gleichzeitig erfolgt.

[0010] Für die Durchführung des Lötvorganges regelt man die Temperatur des Heizgasstroms bei festgehaltener Kunststofffolie praktisch in der Weise, dass zunächst eine Vorheizung der Lötstellen für eine den Lötwerkstoff aktivierende Zeit erfolgt, woraufhin die Temperatur des Heizgasstrom bis zum Schmelzen des im Lötwerkstoff enthaltenen Lots kurzzeitig erhöht und danach schnell abgesenkt wird. Aufgrund dieser Verfahrensweise wird dafür gesorgt, dass für das eigentliche Löten, das beim Schmelzen des im Lötwerkstoff enthaltenen Lots erfolgt, nur eine minimale Zeit erforderlich ist, da vor dem Schmelzen des Lötwerkstoffs die Vorheizung der Lötstellen für eine den Lötwerkstoff aktivierenden Zeit erfolgt, so dass also nur ein ganz kurzzeitiger Temperaturstoß erforderlich ist, um das Lot zum Schmelzen zu bringen, wodurch die Kunststofffolie sicher vor einer zu hohen Erwärmung geschützt wird.

[0011] Das Absenken der Temperatur des Heizgasstrom nach dem Löten geschieht zweckmäßig dadurch, dass der Heizgasstrom nach dem Schmelzen abgeschaltet wird. Darüber hinaus ist es auch möglich den Heizgasstrom in einen Kühlstrom umzuwandeln, um besonders schnell dafür zu sorgen, dass keinerlei schädigende Wärme im Bereich der Kunststofffolie verbleiben kann.

[0012] Eine Vorrichtung zur Durchführung des vorstehend beschriebenen Verfahrens gestaltet man zweckmäßig so, dass sie ein Heizgebläse aufweist, vor dem die Kunststofffolie mit den an ihr gehaltenen Bauteilen positionierbar ist, und auf der der Heizgasgebläse abgewandten Seite der Kunststofffolie eine Heizplatte zum Vorheizen der Kunststofffolie eine Schablone einschiebbar angeordnet ist und die Heizplatte hinsichtlich ihres Abstandes von der Kunststofffolie verschiebbar angeordnet ist. Wenn dann die oben erwähnte Wärmeisolierung der Kunststofffolie erfolgen soll, dann geschieht dies zweckmäßigerweise durch Vergrößern des Abstandes der Heizplatte von der Kunststofffolie, womit sich ein mit Gas gefüllter größerer Zwischenraum ergibt, der wie eine Isolation wirkt. Um auch auf Seiten des Kunststofffolie durch erhöhte Erwärmung nicht auftreten 65 Heizgebläses die Energie hinsichtlich der zu beaufschlagenden Stellen zu konzentrieren, versieht man das Heizgasgebläse zweckmäßig mit positionierbaren Auslässen, wodurch sich jede beliebige Strömungskonzentration auf ausge20

wählte Stellen ermöglichen lässt insbesondere natürlich auf die zu verlötenden Stellen. Für die Schablone kann man vorteilhaft einen flächigen Werkstoff verwenden, der eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt. In diesem Fall kann man die Schablone leicht gegen die Kunststofffolie drücken und diese damit während des Lötprozesses festhalten. Es ist aber auch möglich, die Schablone aus einem Metallblech zu gestalten, das in diesem Falle wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit von Metall in einem Abstand zu dieser Kunststofffolie zu halten ist. Darüber hinaus ist es möglich, die Schablone mit einem Innenraum für die Aufnahme eines Kühlmediums zu versehen. Auf diese Weise lässt sich mittels der gekühlten Schablone dafür sorgen, dass die von der Schablone abgedeckten Bereiche der Kunststofffolie durch deren niedrige Temperatur zusätzlich besonders geschützt werden. 15 [0013] In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 die Positionierung des Lötguts (Kunststofffolie mit aufgebrachten Leiterbahnen und elektrischen Bauteilen) positioniert in der Vorrichtung;

[0015] Fig. 2 das Vorheizen des Lötguts;

[0016] Fig. 3 das Löten mit Heizgas;

[0017] Fig. 4 der Auslauf des gelöteten Lötguts aus der Vorrichtung;

[0018] Fig. 5 die Anordnung einer Metallschablone in Bezug auf das Lötgut;

[0019] Fig. 6 die Anordnung einer Schablone aus Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit;

[0020] Fig. 7 die Anordnung einer Schablone mit Innenkühlung in Bezug auf das Lötgut;

[0021] Fig. 8 eine Heizgaszuführung mit umfassender Erstreckung;

[0022] Fig. 9 eine Heizgaszuführung konzentriert durch Düsen;

[0023] Fig. 10 ein Ausführungsbeispiel für ein als Flexlei- 35 ter ausgebildetes Lötgut;

[0024] Fig. 11a, b, c verschieden aufgebrachter Lotwerkstoff;

[0025] Fig. 12 ein Zeitprofil zum Verlöten mittels Lotpaste.

[0026] In Fig. 1 sind die für die Durchführung des Verfahrens erforderlichen Bauteile in prinzipieller Darstellung gezeigt, und zwar die Kunststofffolie 1 mit aufgebrachten elektrischen Bauteilen 2, 3 (Einzelbauteile und integrierte Schaltkreise), die auf der betreffenden Oberfläche der 45 Kunststofffolie 1 durch in Fig. 1 nicht sichtbare Leiterbahnen (siehe Fig. 10) verbunden sind. Unterhalb der Kunststofffolie ist die für die Aufheizung der Kunststofffolie 1 dienende Heizplatte 4 angeordnet, oberhalb der Kunststofffolie 1 die ein- und ausschiebbare Schablone 5, in die Fen- 50 ster 6 und 7 eingeschnitten sind, wodurch eine weiter unten erläuterte Wärmezufuhr auf den Bereich dieser Fenster begrenzt wird. Die Fig. 1 zeigt die Vorrichtung im Zustand der Positionierung des Lötguts, wobei zunächst aus räumlichen Gründen die Heizplatte 4 und die Schablone 5 einen gewis- 55 sen Abstand von dem Lötgut einhalten.

[0027] In Fig. 2 ist der Verfahrensschritt der Aufheizung der Kunststofffolie 1 mittels der Heizplatte 4 dargestellt, die gemäß dem neben der Heizplatte 4 dargestellten Pfeil an die Kunststofffolie 1 herangeführt ist, und zwar an die den elektrischen Bauteilen abgewandte Seite. Mittels der an der Kunststofffolie 1 anliegenden Heizplatte 4, die gegebenenfalls auch mit einem geringen Abstand von der Kunststofffolie gehalten werden kann, wird nun die Kunststofffolie 1 aufgeheizt, wodurch, wie oben erwähnt, der weitere Wärmebedarf für das Verlöten der elektrischen Bauteile entsprechend vermindert wird. Während dieses Aufheizvorganges erfolgt bereits die Zuführung von Wärme zu der die elektri-

schen Bauteile tragenden Seite der Kunststofffolie 1 durch den Heizgasstrom 6. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Zuführung des Heizgasstromes nicht nur während der Aufheizung der Kunststofffolie erfolgen kann, sondern auch nachdem die Heizung der Kunststofffolie begonnen hat.

[0028] Fig. 3 zeigt die Vorrichtung im Zustand des Verfahrensschritts des Lötens durch den Heizgasstrom 6, wobei zwecks Vermeidung übermäßiger Wärmezufuhr zu der Kunststofffolie 1 die Heizplatte 4 gegenüber der Position gemäß Fig. 2 geringfügig abgesenkt ist und damit einen kleinen Zwischenraum 8 zwischen Kunststofffolie 1 und Heizplatte 4 herbeiführt, der den Effekt einer Wärmeisolierung hat, so dass einerseits von der Heizplatte 4 keine Wärme mehr an die Kunststofffolie 1 abgegeben werden kann, andererseits diese aber auch ihre Temperatur nicht verliert. Der durch die Fenster 6 und 7 in der Schablone 5 auf die elektrischen Bauteile 2 und 3 einwirkende Heizgasstrom 9 wird durch die Fenster 2 und 3 kanalisiert und auf die elektrischen Bauteile 2 und 3 konzentriert, so dass eine übermäßige Erwärmung der Kunststofffolie 1 vermieden wird.

[0029] In der Fig. 4 ist die Vorrichtung in der Position dargestellt, in der die Kunststofffolie 1 mit den auf ihr verlöteten elektrischen Bauteilen 2 und 3 sowie den diese verbindenden Leiterbahnen verlötet aus der Vorrichtung ausgeführt wird (siehe Pfeil bei der Kunststofffolie 1), wobei vorher die Schablone 5 und die Heizplatte 4 von der Kunststofffolie 1 wegbewegt worden sind.

[0030] Wie bereits oben erwähnt, können für die Schablonen verschiedene Materialien verwendet werden. In Fig. 5 ist die Verwendung einer Metallschablone 10 schematisch angedeutet, die beim Löten in einem Abstand von der Kunststofffolie 1 gehalten wird. Bei der Darstellung gemäß Fig. 6 handelt es sich um eine Schablone mit geringer Wärmeleitfähigkeit, also gegebenenfalls um einen wärmebeständigen Kunststoff, der beim Löten auf die Kunststofffolie 1 aufgelegt wird.

[0031] Fig. 7 zeigt die Verwendung einer Schablone 12 mit Innenkühlung. Es handelt sich dabei um eine Schablone mit einem Hohlraum 13, der von einem Kühlmedium durchströmt wird. Mit dieser Schablone lässt sich eine gegebenenfalls wünschenswerte schnelle Abkühlung der Kunststofffolie mit den verlöteten elektrischen Bauteilen herbeiführen, was darum von Vorteil ist, weil bei schneller Abkühlung der Kunststofffolie nach dem Löten diese besonders gut vor einer Schädigung bewahrt wird.

[0032] In den Fig. 8 und 9 ist in Gegenüberstellung die Beaufschlagung der Kunststofffolie mit dem Heizgasstrom 9 dargestellt, und zwar gemäß Fig. 8, mit umfassender Zuführung (siehe Fig. 2 und 3) und in Fig. 9 mit der Zuführung des Heizgasstroms über schematisch dargestellte Düsen 14, die zusätzlich zu den Fenstern 6 und 7 in der Schablone 5 eine besondere Konzentrierung des Heizgasstroms 9 bewirken und damit eine Erwärmung der Kunststofffolie 1 im Bereich außerhalb der elektrischen Bauteile unterdrücken.

[0033] In der Fig. 10 ist ein Ausführungsbeispiel eines Lötguts in Form eines sog. Flexleiters dargestellt, der aus den größeren Folienbereichen 15, 16 und 17 und den diese verbindenden Leitungsstrecken 18 und 19 besteht, wobei die letzteren schmale Streifen der Kunststofffolie bilden, auf die elektrische Leiterbahnen aufgebracht sind. Derartige Flexleiter erlauben die Verlegung innerhalb enger Räume, z. B. in der Karosserie eines Automobils, in dem die Verbindungen vielfach an mehreren Stellen eng gekrümmt verlaufen müssen und in die Karosserieform entsprechend einzupassen sind. Dies ist bei der Verwendung von Flexleitern besonders einfach und gegenüber normalen Verdrahtungen darum vorteilhaft, weil Verdrahtungen bei derartiger Verle-

gung immer erheblichen Biegebeanspruchungen ausgesetzt sind und dabei brechen können.

[0034] In der Fig. 11a, b, c sind verschiedene Lötwerkstoffe dargestellt, die auf die Kunststofffolie 1 aufgebracht sind und mittels des vorstehend beschriebenen Verfahrens gelötet werden können. Bei der Fig. 11a handelt es sich um aufgedruckte Lötpaste, bei Fig. 11b um eine Reflow-Vorbelotung und bei Fig. 11c um aufgeklebtes Lot-Preform.

[0035] In Fig. 12 ist das Temperaturprofil bei Anwendung des vorstehend beschriebenen Verfahrens über der Zeitachse 10 t dargestellt. Danach erfolgt zunächst das Vorheizen des Lötguts im Bereich 19, woraufhin bei erreichter Vorheiztemperatur diese über den Bereich 20 festgehalten wird, in dem der Lötwerkstoff aktiviert wird, woraufhin durch den Heizgasstrom eine kurzzeitige Erhöhung der Temperatur der 15 Lötstellen bis zur Temperaturspitze 21 das Löten erfolgt. Danach erfolgt über den Bereich 22 die schnelle Absenkung der zugeführten Wärme, wobei es sich auch um einen gekühlten Gasstrom handeln kann, der, wie ersichtlich, schnell die Temperatur des Lötguts absenkt, die dann endgültig über 20 den Bereich 23 zur Zimmertemperatur abklingt. Aus dem Diagramm gemäß Fig. 12 ist ersichtlich, dass die zum Verlöten erforderliche Temperatur über einen kurzen Temperaturstoß bis zur Temperaturspitze 21 erfolgt, so dass also die Temperaturbelastung des Lötguts und damit insbesondere 25 der Kunststofffolie auf ein Minimum begrenzt wird.

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum Verlöten von elektrischen Bauteilen 30 (2, 3) an mit Lötwerkstoff versehenen Lötstellen auf einer mit aufgebrachten Leiterbahnen versehenen Kunststofffolie (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie (1) auf einer unterhalb ihrer Schädigungstemperatur von der den Bauteilen (2, 3) abgewandten Seite her aufgeheizt wird und die den Bauteilen zugewandte Seite mit einem Heizgasstrom (9) beaufschlagt wird, der durch eine Fenster (6, 7) aufweisende Schablone (5) auf die zu verlötenden Stellen konzentriert wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Aufheizen der Kunststofffolie (1) die den Bauteilen (2, 3) abgewandte Seite wärmeisoliert wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufheizen der Kunststofffolie (1) und die Wärmebeaufschlagung der den Bauteilen (2, 3) zugewandten Seite der Kunststofffolie (1) im Wesentlichen gleichzeitig erfolgt.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei festgehaltener Kunststofffolie (1) die Temperatur des Heizgasstroms (9) derart geregelt wird, dass zunächst eine Vorheizung der Lötstellen für eine den Lötwerkstoff aktivierende Zeit erfolgt, woraufhin die Temperatur des Heizgasstroms (9) bis zum Schmelzen des im Lötwerkstoff enthaltenen Lots kurzzeitig erhöht und danach schnell abgesenkt wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizgasstrom (9) nach dem Schmelzen 60 abgeschaltet wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizgasstrom (9) in einen Kühlstrom umgewandelt wird.
- 7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach 6s einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Heizgasgebläse (9) aufweist, vor dem die Kunststofffolie (1) mit den an ihre gehaltenen Bautei-

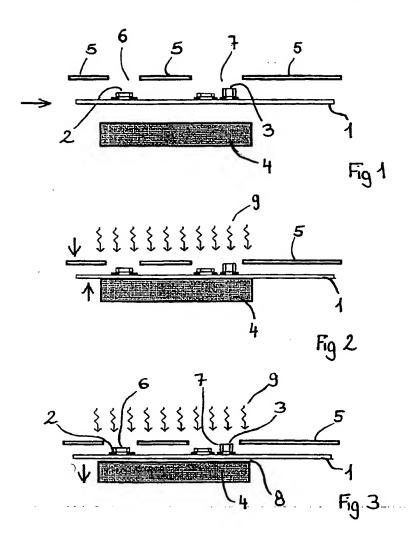
- len (2, 3) positionierbar ist und auf der dem Heizgasgebläse (9) abgewandten Seite der Kunststofffolie (1) eine Heizplatte (4) zum Vorheizen der Kunststofffolie (1) mit Abstand von dieser vorgesehen ist, wobei zwischen Heizgasgebläse (9) und Kunststofffolie (1) eine Schablone (5) einschiebbar angeordnet ist und die Heizplatte (4) hinsichtlich ihres Abstandes von der Kunststofffolie (1) einstellbar angeordnet ist.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizgasgebläse mit positionierbaren Auslässen (14) zur Strömungskonzentration auf ausgewählte Stellen versehen ist.
- 9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schablone (10) aus einem in Abstand zu der Kunststofffolie (1) gehaltenen Metallblech besteht.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schablone (11) aus einem flächigen Werkstoff mit geringe Wärmeleitfähigkeit besteht
- 11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schablone (12) einen Innenraum (13) für die Aufnahme eines Kühlmediums aufweist.

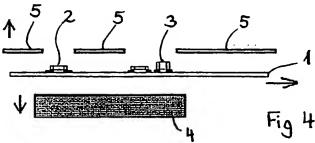
Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

SDOCID: <DE\_\_\_\_\_10133217A1\_i\_>

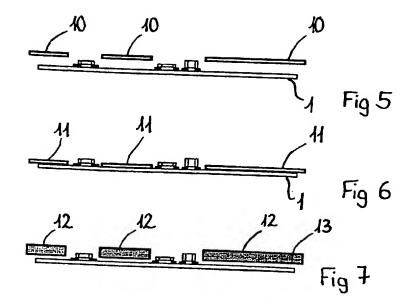
Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag: DE 101 33 217 A1 H 05 K 3/34 23. Januar 2003

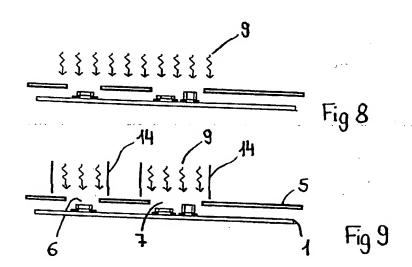




Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag:

DE 101 33 217 A1 H 05 K 3/34 23. Januar 2003





Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag: DE 101 33 217 A1 H 05 K 3/34 23. Januar 2003

